

113 學年度入學-日四技【系畢業門檻：領域】：自我檢核表

詳如以下 2 頁。

113 學年度入學學生，於 114.8.1 入學以後為大二，依此類推。

1. 文件為 114.8.7 版，日後會繼續改版
2. 學生修讀校外實習(一)、或校外實習(二)者，則畢業「檢核二」，認定為免檢核(視為通過)；但不核發領域證書。
↑↑↑這裡的校外實習是指"半年型"的，不是暑假的。
3. 本文件提到有三個畢業資格檢核，與選修、領域、領域必選課程有關。
4. 自我檢核表，師生、系辦仍可繼續「除錯、減少 bugs」；若有錯誤，將記錄日期，重新修改內容。

113 學年度入學-電子工程系日四技【系畢業門檻：領域】——自我檢核表

114.8.7 版，日後會繼續改版

班級：_____ 姓名：_____ 學號：_____

備註：學分計畫表，必選課程以「※」表示，本單改為「★」，意思一樣。

檢核一：學生來自哪一班？舉例：丙班的學生，就看丙班那一欄，即可。

甲班學生要修讀：積體電路與系統應用領域「★」其中的三門	乙班學生要修讀：多媒體遊戲暨智慧運算領域「★」其中的三門	丙班學生要修讀：智慧機器人領域「★」其中的三門
☐ ★VLSI 概論 =(超大型積體電路設計導論)	☐ ★工程軟體應用 =(工程軟體應用實作)	☐ ★工業機器人原理與應用
☐ ★嵌入式軟體設計實務 =(嵌入式軟體設計)	☐ ★嵌入式微處理器系統 =(嵌入式微處理器系統與實習)	☐ ★自動化系統整合與應用
☐ ★太陽能光伏電子系統	☐ ★數位影像處理 =(數位影像處理實作)	☐ ★智慧感測與監控實務
☐ ★半導體物理導論	☐ ★嵌入式系統開發實習	☐ ★電腦機構繪圖
☐ ★光電轉換導論	☐ ★電腦圖學	☐ ★機器人程式設計(1)-初階工程師
☐ ★嵌入式系統應用 =(★嵌入式系統概論與實習)	☐ ★網路概論	☐ ★機器人程式設計(2)-中階工程師
☐ ★電力電子積體電路設計	☐ ★Python 程式語言 =(Python 程式設計)	☐ ★機器視覺
☐ ★類比積體電路設計		
☐ ★FPGA 系統設計 =(FPGA 系統設計實務)		
☐ ★低功率積體電路設計		

註：新增★三門，於 104.11.5 綠能晶片與系統應用領域會議決議通過。

檢核三：

畢業至少應修滿 128 學分【必修 75 學分，選修至少 53 學分(須含本系專業選修至少 36 學分)】。

一、舉例：【專業選修】佔 ≥ 36 學分：指領域選修、電子系日夜所開四技、二技選修。

二、舉例：【非專業選修】得佔 ≤ 17 學分：指跨系選修、體育選修、軍訓選修.....。

三、問：我的博雅通識領域課程選修，多修了，是否可轉為【非專業選修】？ 答：可算是【非專業選修】。

■113 學年度入學-日四技，學分計畫表，下載：<https://bit.ly/2TJci5F>

■本表改版，會公布在系網，短址為：<https://bit.ly/3xntnkm>

檢核二：關鍵字：「領域」不會綁學生來自哪一班、或哪一個招生組別；代表可以自由跨組選修。

甲乙丙學生應修讀下述三個「領域」其中一個，為其畢業之基本條件。

舉例：甲班可自由選擇「積體.....領域」、或「多媒體.....領域」、或「智慧.....領域」，為學生本人的(選修聚焦)領域。

註：學生修讀校外實習(一)、或校外實習(二)者，則畢業「檢核二」，認定為免檢核(視為通過)；但不核發領域證書。

↑↑↑ 這裡的校外實習是指"半年型"的，不是暑假的。

積體電路與系統應用領域： 學生至少要修以下 7 門課；且 含「★」的課，要佔 2 門或以上。	多媒體遊戲暨智慧運算領域： 學生至少要修以下 7 門課；且 含「★」的課，要佔 2 門或以上。	智慧機器人領域： 學生至少要修以下 7 門課；且 含「★」的課，要佔 2 門或以上。
☐ ★VLSI 概論 =(超大型積體電路設計導論)	☐ ★工程軟體應用 =(工程軟體應用實作)	☐ ★工業機器人原理與應用
☐ ★嵌入式軟體設計實務 =(嵌入式軟體設計)	☐ ★嵌入式微處理器系統 =(嵌入式微處理器系統與實習)	☐ ★自動化系統整合與應用
☐ ★太陽能光伏電子系統	☐ ★數位影像處理 =(數位影像處理實作)	☐ ★智慧感測與監控實務
☐ ★半導體物理導論	☐ ★嵌入式系統開發實習	☐ ★電腦機構繪圖
☐ ★光電轉換導論	☐ ★電腦圖學	☐ ★機器人程式設計(1)-初階工程師
☐ ★嵌入式系統應用 =(★嵌入式系統概論與實習)	☐ ★網路概論	☐ ★機器人程式設計(2)-中階工程師
☐ ★電力電子積體電路設計	☐ ★Python 程式語言 =(Python 程式設計)	☐ ★機器視覺
☐ ★類比積體電路設計	☐ 計算機組織與結構 =(計算機結構)	☐ 深度學習 =(深度學習應用)
☐ ★FPGA 系統設計 =(FPGA 系統設計實務)	☐ 作業系統概論 =(作業系統)	☐ 單晶片微電腦應用 =(單晶片微電腦應用實務)
☐ ★低功率積體電路設計	☐ 深度學習 =(深度學習應用)	☐ 嵌入式微處理器系統 =(嵌入式微處理器系統與實習)
☐ 3D 列印技術實務 =(3D 列印導論與實務) =(3D 列印原理與實務)	☐ 3D 動畫技術	☐ 工程圖學
☐ 全客戶 IC 佈局	☐ 物件導向程式設計	☐ 工業無線通訊技術
☐ 太陽能系統與應用	☐ 虛擬實境	☐ 可攜式電源設計
☐ 半導體元件導論	☐ 雲端科技應用	☐ 自動化光學檢測概論
☐ 射頻積體電路導論	☐ 遊戲企劃	☐ 自動化圖控介面
☐ 高速 PCB 設計	☐ 遊戲製作	☐ 控制系統
☐ 微控制器系統實務	☐ 演算法	☐ 電力電子學
☐ 電磁相容之標準與測試	☐ 遊戲物理導論	☐ 機構設計
☐ 電磁相容原理	☐ 物聯網概論	☐ 機器學習
☐ 積體電路製程	☐ 人工智慧	☐ 自動化設備設計與組裝
☐ 電路板製造與產業概論	☐ 機率與統計	☐ 光機電整合
☐ 人工智慧晶片導論	☐ 影像處理概論	
☐ IC 測試技術	☐ 視窗程式設計	
☐ IC 封裝技術	☐ 數位信號處理	
☐ 半導體元件模擬	☐ 資料庫系統應用	
☐ 運算放大器設計實務	☐ 3D 物件建模技術	
☐ 電磁相容實務	☐ 單晶片微電腦應用 =(單晶片微電腦應用實務)	
☐ 半導體設備概論	☐ 資料結構	
☐ 記憶體元件	☐ 數位成音(一)	
☐ 材料科學概論	☐ 數位成音(二)	
☐ 生醫感測器概論	☐ 機器人程式設計 =(工業機器人程式設計)	
☐ 數位 IC 導論	☐ 機器學習	
☐ 電能轉換電路設計	☐ 虛實整合製作	
☐ 印刷電路板製程技術與檢測		
☐ 電子封裝技術與材料		
☐ 半導體薄膜工程與元件		
☐ 微波工程導論		